

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年9月24日(24.09.2020)



(10) 国際公開番号

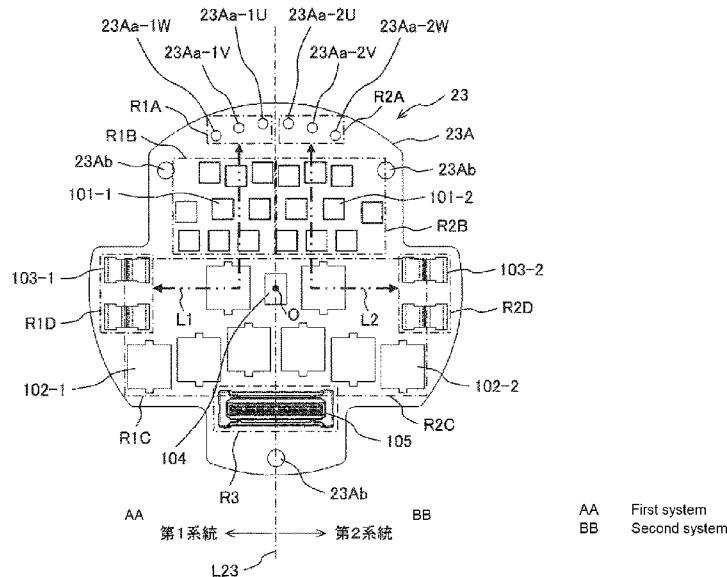
WO 2020/188934 A1

- (51) 国際特許分類:
H02M 7/48 (2007.01) *B62D 5/04* (2006.01)
H02K 11/33 (2016.01) *H05K 7/14* (2006.01)
H02P 25/22 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2019/050495
- (22) 国際出願日: 2019年12月24日(24.12.2019)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2019-050819 2019年3月19日(19.03.2019) JP
- (71) 出願人: 日立オートモティブシステムズ株式会社(HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.) [JP/JP]; 〒3128503 茨城県ひたちなか市高場 2 5 2 0 番地 Ibaraki (JP).
- (72) 発明者: 福田 友宏 (FUKUDA Tomohiro); 〒3128503 茨城県ひたちなか市高場 2 5 2 0 番地 日立オートモティブシステムズ株式会社内 Ibaraki (JP). 水橋 嘉章(MIZUHASHI Yoshiaki); 〒3128503 茨城県ひたちなか市高場 2 5 2 0 番地 日立オートモティブシステムズ株式会社内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 戸田 裕二(TODA Yuji); 〒1008220 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 1 号 株式会社日立製作所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,

(54) Title: ELECTRONIC CONTROL DEVICE AND METHOD FOR ASSEMBLING ELECTRONIC CONTROL DEVICE

(54) 発明の名称: 電子制御装置及び電子制御装置の組立方法

図 4



(57) Abstract: The purpose of the present invention is to improve component mounting efficiency. The electronic control device according to the present invention is provided with: a power supply board 23 having a first insertion hole portion R1A and a second insertion hole portion R2A, said first insertion hole portion R1A having a plurality of holes 23Aa-2U, 23Aa-2V, 23Aa-2W into which the coil wires of a first system are inserted, said second insertion hole portion R2A having a plurality of holes 23Aa-2U, 23Aa-2V, 23Aa-2W into which the coil wires of a second system are inserted; a control

BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))

board 25 provided on an upper portion of the power supply board 23; and an inter-board connector 105 for electrically connecting the power supply board 23 and the control board 25. The first insertion hole portion R1A and the second insertion hole portion R2A are collectively disposed on the same side of the power supply board 23.

(57) 要約: 本発明の目的は、部品の実装効率を向上することにある。本発明の電子制御装置は、第1系統のコイル線が挿通される複数の孔23Aa-2U, 23Aa-2V, 23Aa-2Wを有する第1挿通孔部R1Aと第2系統のコイル線が挿通される複数の孔23Aa-2U, 23Aa-2V, 23Aa-2Wを有する第2挿通孔部R2Aとを有する電源基板23と、電源基板23の上部に設けられる制御基板25と、電源基板23と制御基板25とを電氣的に接続する基板間コネクタ105と、を備え、第1挿通孔部R1Aと第2挿通孔部R2Aとは、電源基板23の同一側にまとめて配置されている。

明 細 書

発明の名称： 電子制御装置及び電子制御装置の組立方法

技術分野

[0001] 本発明は、電動パワーステアリング装置に備えられるのに好適な電子制御装置と、その組立方法に関する。

背景技術

[0002] 本技術分野の背景技術として、特開 2 0 1 6 - 3 6 2 4 4 号公報（特許文献 1）に記載された電動パワーステアリング装置の駆動装置が知られている。

[0003] 特許文献 1 の駆動装置では、基板 4 1 は、モータの一方の側に設けられる。第 1 スイッチング素子（SW素子）5 1 ～ 5 6 は、発熱素子実装面 4 2 に配置される。第 2 スイッチング素子（SW素子）6 1 ～ 6 6 は、基板 4 1 の第 1 スイッチング素子 5 1 ～ 5 6 が配置される面と同一の面であって、第 1 スイッチング素子 5 1 ～ 5 6 が配置される第 1 領域 R 1 とモータ 1 0 の軸中心 O を挟んで反対側の領域である第 2 領域 R 2 に配置される。第 1 モータ線 1 3 5 は、第 1 巻線組から相毎に取り出されて基板 4 1 に配列され、第 2 モータ線 1 4 5 は、第 2 巻線組から相毎に取り出されて基板 4 1 に配列される。第 1 モータ線 1 3 5 および第 1 スイッチング素子 5 1 ～ 5 6 と、第 2 モータ線 1 4 5 および第 2 スイッチング素子 6 1 ～ 6 6 とは、電力供給領域 R i n の側からの相配列が逆順である。これにより、電力供給領域 R i n からの配線長の相間ばらつきが低減される。以上、要約参照のこと。なお、上記の符号は特許文献 1 に記載された符号をそのまま記載しており、本明細書及び図面における符号とは関係がない。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献 1：特開 2 0 1 6 - 3 6 2 4 4 号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] 特許文献 1 の駆動装置では、第 1 モータ線及び第 1 スイッチング素子と第 2 モータ線及び第 2 スイッチング素子とがモータの軸中心を挟んで反対側の領域に配置されている。第 1 モータ線と第 1 スイッチング素子とは近接した位置に配置することが好ましく、第 2 モータ線と第 2 スイッチング素子とは近接した位置に配置することが好ましい。また、第 1 スイッチング素子及び第 2 スイッチング素子は発熱素子であるため、第 1 スイッチング素子が配置される第 1 領域及び第 2 スイッチング素子が配置される第 2 領域における基板の裏面側（発熱素子実装面に対して反対側の面）は、フレーム部材（本明細書では、基体という）に接触させ、基板からフレーム部材への放熱効果を高めることが好ましい。この場合、第 1 領域及び第 2 領域における基板の裏面側には部品を実装することができない。

[0006] 装置の小型化のためには、基板の裏面側を部品の実装面として有効活用することが好ましい。この場合、特許文献 1 の駆動装置のように、第 1 モータ線及び第 1 スイッチング素子と第 2 モータ線及び第 2 スイッチング素子とがモータの軸中心を挟んで反対側の領域に配置されていると、基板とフレーム部材との接触部が分散配置されることになり、基板裏面側における部品の実装効率が低下する。

[0007] 本発明の目的は、部品の実装効率を向上することにある。

課題を解決するための手段

[0008] 上記目的を達成するために、本発明の電子制御装置は、
第 1 系統のコイル線が挿通される複数の孔を有する第 1 挿通孔部と、
第 2 系統のコイル線が挿通される複数の孔を有する第 2 挿通孔部と、を有する電源基板と、
前記電源基板の上部に設けられる制御基板と、
前記電源基板と前記制御基板とを電氣的に接続する基板間コネクタと、を備え、
前記第 1 挿通孔部と前記第 2 挿通孔部とは、前記電源基板の同一側にまと

めて配置されている。

発明の効果

[0009] 本発明によれば、発熱部品を集約することができ、電源基板の裏面側を有効に活用することができるため、部品の実装効率を向上することができる。上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。

図面の簡単な説明

[0010] [図1]本発明の一実施例に係る電動パワーステアリング装置の全体斜視図である。

[図2]本発明の一実施例に係る電動パワーステアリング装置の電子制御装置の断面を含む分解斜視図である。

[図3]図2から制御基板を除いた電子制御装置の斜視図である。

[図4]電源基板のスイッチング素子搭載面を示す平面図である。

[図5]基体に電源基板を組み付けた状態を示す、断面を含む斜視図である。

[図6A]電源基板のたわみ防止構造を示す斜視図である。

[図6B]たわみ防止構造の配置とたわみ量の解析における荷重の入力位置を示す電源基板の斜視図である。

[図6C]たわみ防止構造を設けた場合のたわみ量の解析結果を示す電源基板の斜視図である。

[図6D]たわみ防止構造が無い場合のたわみ量の解析結果を示す電源基板の斜視図である。

[図7]コイル線の末端処理について説明する概念図である。

[図8]コイル線の末端処理に用いる櫛歯冶具を示す図である。

発明を実施するための形態

[0011] 本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。なお、以下の説明では上下方向及び左右方向を指定して説明する場合があるが、この上下方向及び左右方向は図2－5，8における上下方向及び左右方向に基づいており、装置の実装状態における上下方向及び左右方向とは必ずしも一致しない。

[0012] 図1は、本発明が適用される一例としての電動パワーステアリング装置1の全体斜視図である。

[0013] 電動パワーステアリング装置1は、自動車の操舵輪（通常、前輪）を操舵するための装置であり、図1に示すように構成されている。図示しないステアリングホイールに連結されたステアリングシャフト2の下端には図示しないピニオンが設けられ、このピニオンは車体左右方向に長い、図示しないラックと噛み合っている。このラックの両端には前輪を左右方向へ操舵するためのタイロッド3が連結されており、ラックはラックハウジング4に覆われている。そして、ラックハウジング4とタイロッド3との間にはゴムブーツ5が設けられている。

[0014] ステアリングホイールを回動操作する際のトルクを補助するため、電動駆動装置6が設けられている。電動駆動装置6は、ステアリングシャフト2の回動方向と回動トルクとを検出するトルクセンサ7と、トルクセンサ7の検出値に基づいてラックにギヤ10を介して操舵補助力を付与する電動モータ部8と、電動モータ部8に配置された電動モータを制御する電子制御装置（ECU）9と、を備える。電動駆動装置6の電動モータ部8は、出力軸側の外周部の複数箇所が図示しないボルトを介してギヤ10に接続され、電動モータ部8の出力軸側とは反対側の端部に電子制御装置9が設けられている。なお、トルクセンサ7は電動駆動装置6とは別に構成される場合もある。

[0015] 電動駆動装置6においては、ステアリングホイールが操作されることによりステアリングシャフト2がいずれかの方向へ回動操作されると、このステアリングシャフト2の回動方向と回動トルクをトルクセンサ7が検出し、この検出値に基づいて電子制御装置9が電動モータの駆動操作量を演算する。この演算された駆動操作量に基づき、電源基板（インバータ基板、電力変換基板）23（図2参照）のスイッチング素子101により電動モータが駆動され、電動モータの出力軸はステアリングシャフト2を操作方向と同じ方向へ駆動するように回動される。出力軸の回動は、図示しないピニオンからギヤ10を介して図示しないラックへ伝達され、自動車が操舵されるものであ

る。これらの構成、作用は既によく知られているので、これ以上の説明は省略する。

[0016] 図2は、本発明の一実施例に係る電動パワーステアリング装置1の電子制御装置9の断面を含む分解斜視図である。図3は、図2から制御基板23を除いた電子制御装置9の斜視図である。なお図2では、電源基板23及び制御基板25を覆うカバーは図示を省略している。

[0017] 電子制御装置9は、電動モータの、回転軸（出力軸）の軸方向ADに沿う一端部（出力軸側とは反対側の端部）に固定されている。本実施例では、電動モータの回転軸（出力軸）を基準にして軸方向ADを規定し、以下の説明では回転軸の軸方向ADに沿う方向を単に軸方向と呼んで説明する。

[0018] 図2に示すように、電子制御装置9は、基体（basic substance）21と、基体21に固定される電源基板23及び制御基板25と、を備えて構成される。電子制御装置9は、基体21が電動モータ部8のモータハウジング（図示せず）に固定される。基体21及びモータハウジングは、アルミ合金等を用いて製作される。電源基板23及び制御基板25は軸方向ADにおいて積層され、電源基板23が制御基板25に対して基体21側（下側）に配置される。すなわち制御基板25は、電源基板23に対して、基体21側とは反対側（上側）に配置される。

[0019] 電動モータ部8に設けられた電動モータのコイルの引き出し線（コイル入力端子）8Aは、基体21を貫通して電源基板23の上面側（基体21側とは反対側）に引き出され、電源基板23のスイッチング素子101の出力端子に、電氣的に接続される。このために、電源基板23の基板部材（電源基板部材）23Aには貫通孔23Aaが設けられ、コイル入力端子8Aは貫通孔23Aaを挿通して電源基板23の上面側に引き出される。コイル入力端子8Aは基板部材23Aに半田付けされ、電源基板23に電氣的に接続される。

なお、半田に限定されるものではなく、ヒュージング（熱かしめ）、TIG溶接、プレスフィット等でもよい。

[0020] 本実施例では、前述したコイルの引き出し線（コイル入力端子）8 Aはコイルの一部として扱い、単にコイルと呼んで説明する。

[0021] 電源基板23には、スイッチング素子101、コンデンサ102、電源端子103、磁気センサ104、基板間コネクタ105及びFSリレー／パワーチョークコイル106（図5参照）等が配置され、これらの電気電子部品が電源回路（電力変換回路）を構成する。スイッチング素子101は直流電源を3相交流電源に変換する。コンデンサ102は、アルミ電解コンデンサ等で構成され、充放電を行うことによりスイッチングノイズ等の電圧変動を抑制する。電源端子103は外部電源が接続される端子である。磁気センサ104は電動モータの回転角を検出するセンサである。基板間コネクタ105は制御基板25との電氣的接続を行う回路部品である。FSリレー／パワーチョークコイル106のうちFSリレーは故障時に電動モータに流れる電流を遮断する回路部品であり、パワーチョークコイルはスイッチングノイズの伝搬を抑制する回路部品である。

[0022] 図4は、電源基板23のスイッチング素子搭載面を示す平面図である。

[0023] 本実施例では、電動モータ部8のコイルと、スイッチング素子101、コンデンサ102及び電源端子103を含む駆動回路とは、二系統が設けられる。二系統を区別する必要がある場合は、各部品を「第1」及び「第2」のようにナンバリングを行って説明する。

[0024] Oは電動モータの回転軸の中心（軸中心）が対向している位置である。本実施例では、第1系統と第2系統とが、軸中心位置Oを通り基板23の部品実装面に平行な直線L23を境界として、直線L23に対して左右に分かれて配置される。なお、直線L23に対して左側を第1系統、右側を第2系統と呼ぶことにする。

[0025] 電源基板（インバータ基板、電力変換基板）23の電源基板部材23Aは、第1系統の（給電される側の）コイル引き出し線8Aが挿通される複数の孔（貫通孔、コイル引き出し線挿通孔）23Aa-1U, 23Aa-1V, 23Aa-1Wを有する第1挿通孔部R1Aと、第2系統の（給電される側

の) コイル引き出し線 8 A が挿通される複数の孔 (貫通孔、コイル引き出し線挿通孔) 2 3 A a - 2 U, 2 3 A a - 2 V, 2 3 A a - 2 W を有する第 2 挿通孔部 R 2 A と、を有する。

[0026] 電源基板 2 3 の上側 (基体 2 1 側とは反対側) は制御基板 2 5 が設けられ、電源基板 2 3 と制御基板 2 5 とは基板間コネクタ 1 0 5, 2 0 2 により電氣的に接続される。このために、電源基板 2 3 には基板間コネクタ 1 0 5 が設けられ、制御基板 2 5 には基板間コネクタ 2 0 2 が設けられる。なお、制御基板 2 5 は電動モータを制御するための制御信号を計算するための集積回路 2 0 1 等が設けられる。

[0027] 第 1 挿通孔部 R 1 A と第 2 挿通孔部 R 2 A とは、直線 L 2 3 に沿う方向において、軸中心位置 O に対して、電源基板 2 3 の同一側にまとめて配置されている。すなわち、第 1 挿通孔部 R 1 A 及び第 2 挿通孔部 R 2 A は、直線 L 2 3 に沿う方向において、軸中心位置 O に対して、同一側に集約されて配置されている。この場合、第 1 挿通孔部 R 1 A 及び第 2 挿通孔部 R 2 A は、電源基板 2 3 の外周縁部に配置され、第 1 系統の第 1 孔 2 3 A a - 2 U, 2 3 A a - 2 V, 2 3 A a - 2 W 及び第 2 系統の第 2 孔 2 3 A a - 2 U, 2 3 A a - 2 V, 2 3 A a - 2 W からなる 6 つの孔は、均等な間隔で配置されている。本実施例では、6 つの孔を円弧状に配置しているが、直線状に配置してもよい。

[0028] 電源基板 2 3 上には、第 1 コイル引き出し線 8 A - 1 U, 8 A - 1 V, 8 A - 1 W (図 7 参照)、第 1 スイッチング素子 1 0 1 - 1、第 1 コンデンサ 1 0 2 - 1、及び第 1 電源端子 1 0 3 - 1 が実装されており、第 1 コイル引き出し線 8 A - 1 U, 8 A - 1 V, 8 A - 1 W が接続される第 1 挿通孔部 R 1 A、第 1 スイッチング素子 1 0 1 - 1 が配置される第 1 スイッチング素子実装部 R 1 B、第 1 コンデンサ 1 0 2 - 1 が配置される第 1 コンデンサ実装部 R 1 C、及び第 1 電源端子 1 0 3 - 1 が配置される第 1 電源端子実装部 R 1 D は、L 字状の直線線分 L 1 に沿って、第 1 挿通孔部 R 1 A 側から第 1 電源端子実装部 R 1 D 側に向かって、第 1 挿通孔部 R 1 A、第 1 スイッチング

素子実装部 R 1 B、第 1 コンデンサ実装部 R 1 C、及び第 1 電源端子実装部 R 1 D の順番に配置されている。

[0029] また電源基板 2 3 上には、第 2 コイル引き出し線 8 A - 2 U、8 A - 2 V、8 A - 2 W (図 7 参照)、第 2 スイッチング素子 1 0 1 - 2、第 2 コンデンサ 1 0 2 - 2、及び第 2 電源端子 1 0 3 - 2 が実装されており、第 2 コイル引き出し線 8 A - 2 U、8 A - 2 V、8 A - 2 W が接続される第 2 挿通孔部 R 2 A、第 2 スイッチング素子 1 0 1 - 2 が配置される第 2 スイッチング素子実装部 R 2 B、第 2 コンデンサ 1 0 2 - 2 が配置される第 2 コンデンサ実装部 R 2 C、及び第 2 電源端子 1 0 3 - 2 が配置される第 2 電源端子実装部 R 2 D は、L 字状の直線線分 L 2 に沿って、第 2 挿通孔部 R 2 A 側から第 2 電源端子実装部 R 2 D 側に向かって、第 2 挿通孔部 R 2 A、第 2 スイッチング素子実装部 R 2 B、第 2 コンデンサ実装部 R 2 C、及び第 2 電源端子実装部 R 2 D の順番に配置されている。

[0030] 第 1 系統における第 1 挿通孔部 R 1 A、第 1 スイッチング素子実装部 R 1 B、第 1 コンデンサ実装部 R 1 C、及び第 1 電源端子実装部 R 1 D と第 2 系統における第 2 挿通孔部 R 2 A、第 2 スイッチング素子実装部 R 2 B、第 2 コンデンサ実装部 R 2 C、及び第 2 電源端子実装部 R 2 D とは、直線 L 2 3 に対して線対称に配置される。

[0031] 磁気センサ 1 0 4 は軸中心位置 O に配置される。基板間コネクタ 1 0 5 は、軸中心位置 O を挟んで、第 1 挿通孔部 R 1 A 及び第 2 挿通孔部 R 2 A の反対側に配置される。したがって磁気センサ 1 0 4 は、第 1 挿通孔部 R 1 A 及び第 2 挿通孔部 R 2 A と基板間コネクタ実装部 R 3 との間に配置される。

[0032] 二系統の第 1 コイル引き出し線 8 A - 1 U、8 A - 1 V、8 A - 1 W 及び第 2 コイル引き出し線 8 A - 2 U、8 A - 2 V、8 A - 2 W をまとめて同列に配置することで、組み立て設備の小型化や、配線効率の向上により、実装効率が向上し、基板サイズを低減することができる。また、二系統の第 1 コイル引き出し線 8 A - 1 U、8 A - 1 V、8 A - 1 W 及び第 2 コイル引き出し線 8 A - 2 U、8 A - 2 V、8 A - 2 W をまとめて同列に配置することで

、スイッチング素子 101 やコンデンサ 102 の配置を最適化することができる、製品サイズを小型化することができる。

[0033] 図 5 は、基体 21 に電源基板 23 を組み付けた状態を示す、断面を含む斜視図である。

[0034] 配線を短くするために、第 1 コイル引き出し線 8A-1U, 8A-1V, 8A-1W と第 1 スwitching 素子 101-1 とは近接した位置に配置することが好ましく、第 2 コイル引き出し線 8A-2U, 8A-2V, 8A-2W と第 2 スwitching 素子 101-2 とは近接した位置に配置することが好ましい。また、第 1 スwitching 素子 101-1 及び第 2 スwitching 素子 101-2 は発熱素子であるため、電源基板 23 における第 1 スwitching 素子実装部 R1B 及び第 2 スwitching 素子実装部 R2B の裏面側（発熱素子実装面に対して反対側の面）は、基体 21 に接触させ、電源基板 23 から基体 21 への放熱効果を高めることが好ましい。

[0035] そこで本実施例では、図 2 及び図 5 に示すように、基体 21 に電源基板 23 側に向かって突出する凸部 21D 設け、凸部 21D の上端面を電源基板 23 の裏面に接触させている。この場合、電源基板 23 における第 1 スwitching 素子実装部 R1B 及び第 2 スwitching 素子実装部 R2B の裏面側には部品を実装することができない。

[0036] そこで本実施例では、第 1 コイル引き出し線 8A-1U, 8A-1V, 8A-1W 及び第 2 コイル引き出し線 8A-2U, 8A-2V, 8A-2W をまとめて同列に配置することで、第 1 スwitching 素子 101-1 と第 2 スwitching 素子 101-2 とを集約配置している。すなわち、第 1 スwitching 素子 101-1 及び第 2 スwitching 素子 101-2 が 1 箇所に纏めて電源基板 23 の上面に実装されている。第 1 スwitching 素子実装部 R1B 及び第 2 スwitching 素子実装部 R2B が離隔して配置されると、凸部 21D の範囲が大きくなり、電源基板 23 の裏面側の部品実装面が小さくなる。本実施例では、電源基板 23 における第 1 スwitching 素子実装部 R1B 及び第 2 スwitching 素子実装部 R2B の裏面側が当接する凸部 21D をコン

パクトにまとめることができ、凸部 21D によって失われる空間を減らすことができる。また、第 1 スイッチング素子実装部 R1B 及び第 2 スイッチング素子実装部 R2B が離隔して配置される場合に、凸部 21D を分割すると、電源基板 23 の裏面側の部品実装面が分割され、部品の実装効率が低下する。本実施例では部品実装面が分割されるのを防ぐことができる。これにより本実施例では、電源基板 23 の裏面側における部品の実装効率が向上する。

[0037] 本実施例では、スイッチング素子 101 などの高発熱部品を電源基板 23 の上面に、FS リレー／パワーチョークコイル 106 などの低発熱部品を電源基板 23 の下面に実装し、冷却が必要な部品のみを上面に実装することで基板実装効率を向上させる事ができる。

また、スイッチング素子 101 の裏側には電子部品を搭載しないことで、基体（筐体）21 と電源基板 23 とを接触させることができ、冷却効果を向上することができる。スイッチング素子（MOSFET）101 の集約化によって、基体（筐体）21 を構成するアルミハウジング構造の冷却部を簡易化することができ、これにより製品サイズの低減が可能になる。

[0038] なお、基体 21 は図示しないモータハウジングに図示しないボルトで固定される。このために基体 21 のモータハウジング側の外周には、ボルトを挿通するボルト挿通孔 21A が複数設けられている。また上述したように、基体 21 は電源基板 23 のスイッチング素子 101 等が発生する熱を放熱するヒートシンクを兼ねる部材でもある。このために、基体 21 には凸部 21D が設けられる。すなわち基体 21 は、電源基板 23 の裏面のうちスイッチング素子 101 を含む高発熱部品が実装される実装部の直下に位置する部分と接触する第 1 凸部 21D を有する。電源基板 23 と凸部 21D との接触を確実にするために、基体 21 には電源基板 23 を固定する電源基板固定部 21B が凸部 21D の横に複数設けられている（図 3 参照）。電源基板 23 は、貫通孔 23Ab に図示しないねじが挿通され、電源基板固定部 21B にねじ止めされる。

[0039] なお、制御基板 2 5 は、貫通孔 2 5 A a に図示しないねじが挿通され、基体 2 1 に設けられた固定部（制御基板固定部） 2 1 C a にねじ止めされる。制御基板 2 5 は電源基板 2 3 の上側に離隔して積層配置されるため、制御基板固定部 2 1 C a は電源基板固定部 2 1 B よりも高い位置となるように、凸部 2 1 D の上端面よりも高い位置まで延伸された柱状部 2 1 C の上端面に設けられている。

[0040] 図 6 A は、電源基板のたわみ防止構造を示す斜視図である。図 6 B は、たわみ防止構造の配置とたわみ量の解析における荷重の入力位置を示す電源基板の斜視図である。図 6 C は、たわみ防止構造を設けた場合のたわみ量の解析結果を示す電源基板の斜視図である。

図 6 D は、たわみ防止構造が無い場合のたわみ量の解析結果を示す電源基板の斜視図である。

[0041] 本実施例では、電源基板 2 3 の軸中心位置 O から直線 L 2 3 に垂直な方向の実装面上に、電子部品及び電源端子 1 0 3 を対称配置し、電源基板 2 3 における第 1 電源端子実装部 R 1 D 及び第 2 電源端子実装部 R 2 D の裏面側を基体（筐体） 2 1 と接触させている。すなわち、電源基板 2 3 の軸中心位置 O を通り電源基板 2 3 の基板面に平行な直線 L 2 3 に対して直交し前記基板面に平行な方向の実装面上に、第 1 電源端子 1 0 1 - 1 と第 2 電源端子 1 0 1 - 2 とを直線 L 2 3 に対して対称配置し、電源基板 2 3 における第 1 電源端子実装部 R 1 D 及び第 2 電源端子実装部 R 1 D の裏面側を、電源基板 2 3 を支持する基体 2 1 と接触させている。このために、基体 2 1 に、電源基板 2 3 における第 1 電源端子実装部 R 1 D 及び第 2 電源端子実装部 R 2 D の裏面側と接触する凸部 2 1 F を設けている。

[0042] すなわち基体 2 1 は、電源基板 2 3 の裏面のうち第 1 電源端子（第 1 系統の電源端子）が実装される実装部の直下に位置する部分に接触する第 2 凸部 2 1 F と第 1 電源端子（第 2 系統の電源端子）が実装される実装部の直下に位置する部分と接触する第 3 凸部 2 1 F とを有する。

[0043] 電源端子 1 0 3 には外部電源側の端子が上方から下方に向けて強い力で挿

入される。電源基板 23 は、電源端子 103 を介してこの強い力を受けることでひずむ。図 6 C の凸部 21 F を設けた構造は、図 6 D の凸部 21 F を設けない構造に対して、外部電源端子の接合時に電源基板 23 のひずみ量が抑制されている。

[0044] 本実施例では、電源端子 103 をモータ中心（すなわち、軸中心位置 O）から遠ざけることで、電源基板 23 の外周部に基板たわみ防止構造（凸部 21 F）を設けることが出来き、電源基板 23 のたわみ（ひずみ）を低減することができる。これにより、電源端子 103 の近傍におけるネジ固定を不要とすることができ、電源基板 23 の実装効率が向上する。なお、電源基板 23 では、軸中心位置 O には磁気センサ（回転角度センサ）104 が搭載されているため、基板たわみ防止構造を設けることが出来ない。

[0045] また本実施例では、凸部 21 F と同じ目的で、基板間コネクタ 105 を配置した基板間コネクタ実装部 R3 の裏面側にも、この裏面と接触する凸部 21 E を設けている。すなわち基体 21 は、電源基板 23 の裏面のうち基板間コネクタ 105 が実装される実装部の直下に位置する部分と接触する第 4 凸部を有する。

[0046] 図 7 は、コイル線の末端処理について説明する概念図である。図 8 は、コイル線の末端処理に用いる櫛歯冶具を示す図である。

[0047] 二系統のコイル線を系統毎に纏めて配線し、コイル線の終端が同列直線状になるように、電動モータの内部で矯正することで電源基板 23 側の挿通孔 23 A a を集約化することが可能となり、製品サイズを低減することができる。

[0048] 電動モータ内部でコイル線を矯正して電源基板 23 側に口出しした場合、コイル線の反力でコイル線の寸法位置精度が悪くなり、電源基板 23 との接続が困難となる。そこで、櫛歯冶具 50 A, 50 B にてコイル線位置を固定することで、電動モータ内部で矯正されたコイル線でも電源基板 23 の挿通孔 23 A a への挿入を可能としている。なお、櫛歯冶具以外にもコイルガイド機能を持った部品をモータハウジングに取り付けても良い。

[0049] 本発明に係る実施例では、電子制御装置の組立方法として、下記のような組立方法を実施することができる。

[0050] 第1系統のコイル線8A-1U, 8A-1V, 8A-1Wが挿通される複数の孔23Aa-2U, 23Aa-2V, 23Aa-2Wを有する第1挿通孔部R1Aと、

第2系統のコイル線8A-2U, 8A-2V, 8A-2Wが挿通される複数の孔23Aa-2U, 23Aa-2V, 23Aa-2Wを有する第2挿通孔部R2Aと、を有する電源基板23と、

電源基板23の上部に設けられる制御基板25と、

電源基板23と制御基板25とを電氣的に接続する基板間コネクタ105と、を備え、

第1挿通孔部R1Aと第2挿通孔部R2Aとは、電源基板23の同一側にまとめて配置されている電子制御装置9の組立方法であって、

二系統のコイル線8A-1U, 8A-1V, 8A-1W, 8A-2U, 8A-2V, 8A-2Wを系統毎に纏めて配線し、コイル線8A-1U, 8A-1V, 8A-1W, 8A-2U, 8A-2V, 8A-2Wの終端が同列直線状になるように電動モータ内部で矯正し、第1挿通孔部R1Aの複数の孔23Aa-2U, 23Aa-2V, 23Aa-2W及び第2挿通孔部R2Aの複数の孔23Aa-2U, 23Aa-2V, 23Aa-2Wに挿通して組み立てる。

[0051] なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。

例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、実施例の構成の一部を他の構成に置き換えることが可能であり、実施例の構成の一部について、他の構成を追加することが可能である。

符号の説明

[0052] 1…パワーステアリング装置、8A-1U, 8A-1V, 8A-1W…第

1 系統のコイル線（コイル引き出し線）、8 A－2 U，8 A－2 V，8 A－2 W…第2 系統のコイル線（コイル引き出し線）、9 …電子制御装置、2 3 …電源基板、2 3 A a－2 U，2 3 A a－2 V，2 3 A a－2 W…第1 系統のコイル線挿通孔、2 3 A a－2 U，2 3 A a－2 V，2 3 A a－2 W…第2 系統のコイル線挿通孔、2 5 …制御基板、1 0 5 …基板間コネクタ、R 1 A …第1 挿通孔部、R 2 A …第2 挿通孔部。

請求の範囲

- [請求項1] 第1系統のコイル線が挿通される複数の孔を有する第1挿通孔部と、第2系統のコイル線が挿通される複数の孔を有する第2挿通孔部と、を有する電源基板と、
- 前記電源基板の上部に設けられ、前記電源基板と電氣的に接続される制御基板と、
- 前記電源基板と前記制御基板が固定される金属製の基体と、を備え、
- 前記第1挿通孔部と前記第2挿通孔部とは、前記電源基板の同一側にまとめて配置されている電子制御装置。
- [請求項2] 請求項1に記載の電子制御装置において、
- 前記電源基板は、前記制御基板と電氣的に接続するための基板間コネクタを備え、
- 前記基板間コネクタは、前記第1挿通孔部及び前記第2挿通孔部に対して前記制御基板の中心を挟んで反対側に設けられている電子制御装置。
- [請求項3] 請求項2に記載の電子制御装置において、
- 第1系統のスイッチング素子、第2系統のスイッチング素子、第1系統のコンデンサ、第2系統のコンデンサ、第1系統の電源端子、及び第2系統の電源端子を備え、
- 前記第1系統のコイル線、前記第1系統のスイッチング素子、前記第1系統のコンデンサ、及び前記第1系統の電源端子は、この順番で前記電源基板に実装され、
- 前記第2系統のコイル線、前記第2系統のスイッチング素子、前記第2系統のコンデンサ、及び前記第2系統の電源端子は、この順番で前記電源基板に実装されている電子制御装置。
- [請求項4] 請求項3に記載の電子制御装置において、
- F S リレー及びパワーチョークコイルを備え、

前記スイッチング素子を含む高発熱部品を前記電源基板の上面側に配置し、前記F Sリレー及び前記パワーチョークコイルなどの低発熱部品を前記電源基板の下面側に配置した電子制御装置。

[請求項5] 請求項3又は4に記載の電子制御装置において、
前記基体は、前記電源基板の裏面のうち前記スイッチング素子を含む高発熱部品が実装される実装部の直下に位置する部分と接触する第1凸部を有する電子制御装置。

[請求項6] 請求項3乃至5のいずれかに記載の電子制御装置において、
前記電源基板の軸中心位置を通り前記電源基板の基板面に平行な直線に対して直交し前記基板面に平行な方向の実装面上に、前記第1系統の電源端子と前記第2系統の電源端子とを前記直線に対して対称配置し、前記電源基板における前記第1系統の電源端子の実装面及び第2系統の電源端子の実装面の裏面側を、前記電源基板を支持する基体と接触させている電子制御装置。

[請求項7] 請求項3乃至6のいずれかに記載の電子制御装置において、
前記基体は、前記電源基板の裏面のうち前記第1系統の電源端子が実装される実装部の直下に位置する部分に接触する第2凸部と前記第2系統の電源端子が実装される実装部の直下に位置する部分と接触する第3凸部とを有する電子制御装置。

[請求項8] 請求項2乃至7のいずれかに記載の電子制御装置において、
前記基体は、前記電源基板の裏面のうち前記基板間コネクタが実装される実装部の直下に位置する部分と接触する第4凸部を有する電子制御装置。

[請求項9] 請求項2乃至8のいずれかに記載の電子制御装置において、
前記第1挿通孔部及び前記第2挿通孔部と前記基板間コネクタの実装部との間に実装された磁気センサを備える電子制御装置。

[請求項10] 第1系統のコイル線が挿通される複数の孔を有する第1挿通孔部と、
、

第2系統のコイル線が挿通される複数の孔を有する第2挿通孔部と、
を有する電源基板と、

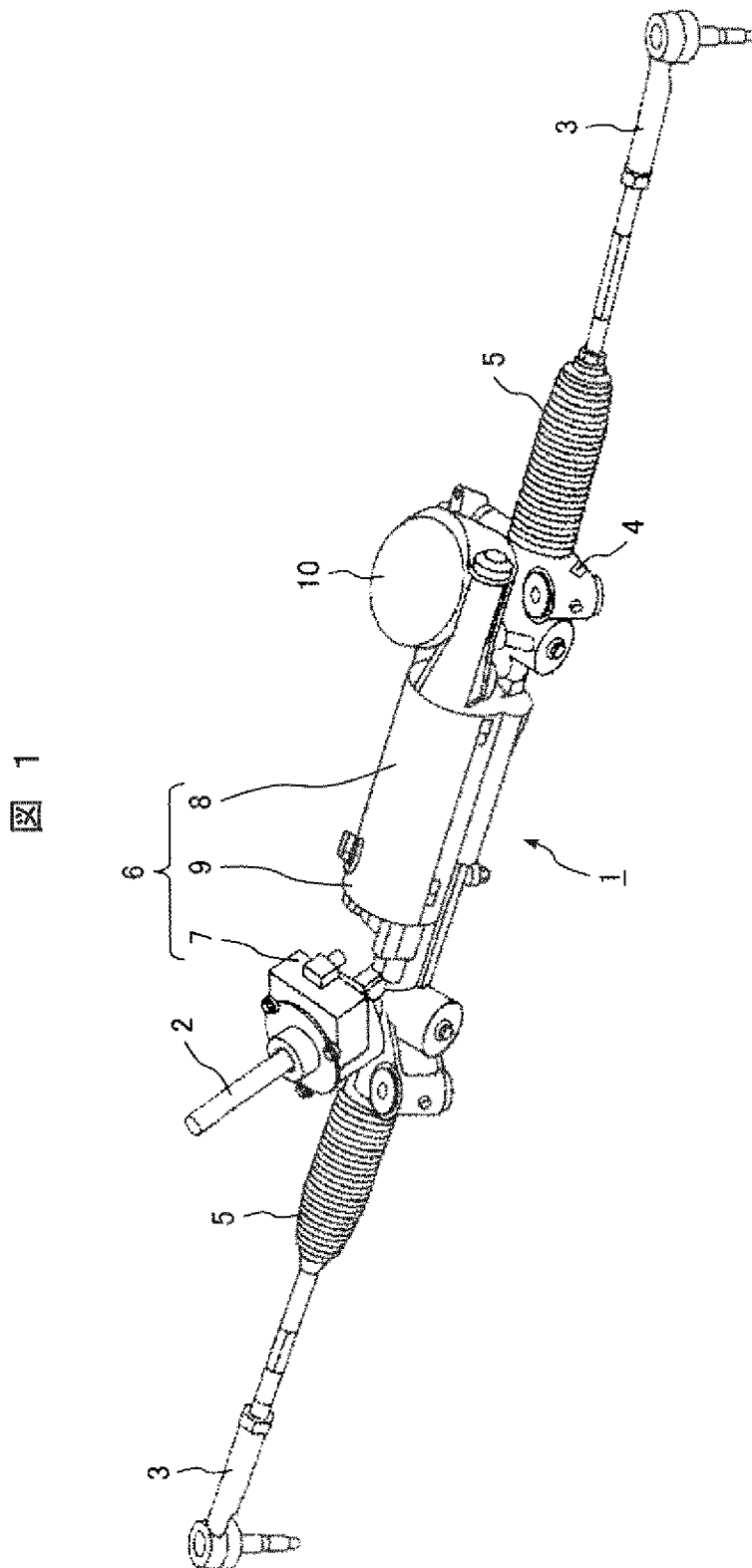
前記電源基板の上部に設けられる制御基板と、

前記電源基板と前記制御基板とを電氣的に接続する基板間コネクタと、を備え、

前記第1挿通孔部と前記第2挿通孔部とは、前記電源基板の同一側にまとめて配置されている電子制御装置の組立方法であって、

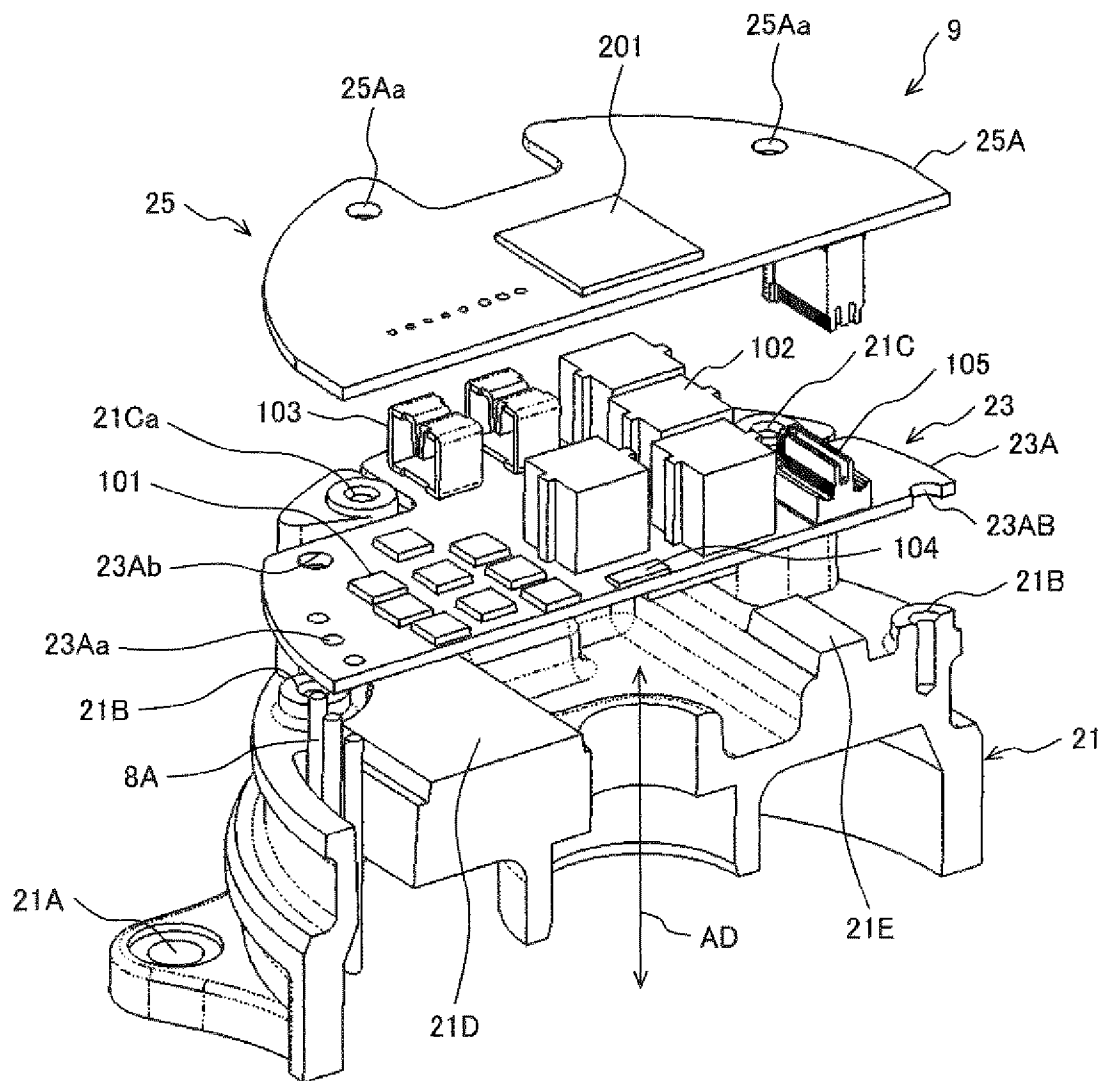
二系統の前記コイル線を系統毎に纏めて配線し、前記コイル線の終端が同列直線状になるように電動モータ内部で矯正し、前記第1挿通孔部の前記複数の孔及び前記第2挿通孔部の前記複数の孔に挿通して組み立てる電子制御装置の組立方法。

[図1]



[図2]

圖 2



[図3]

図 3

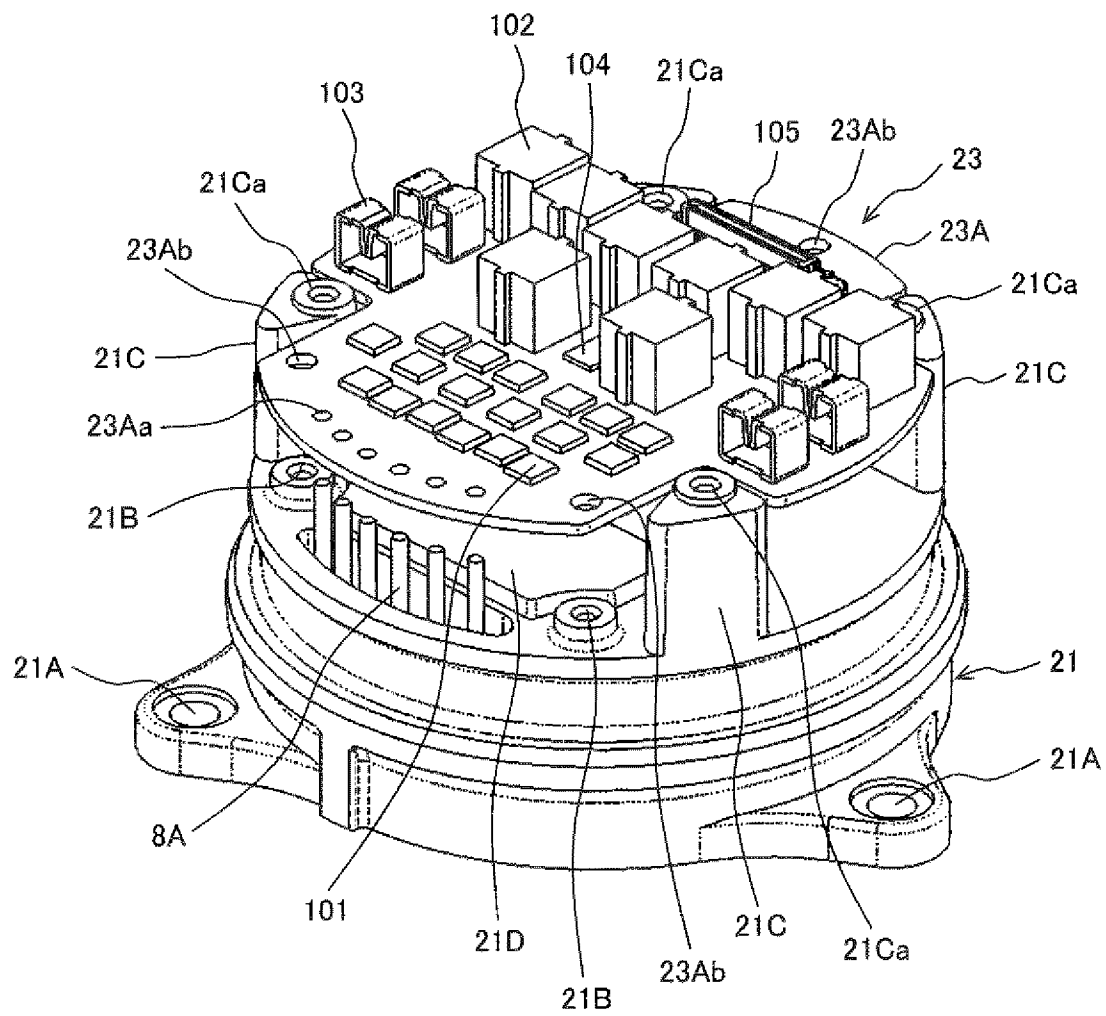
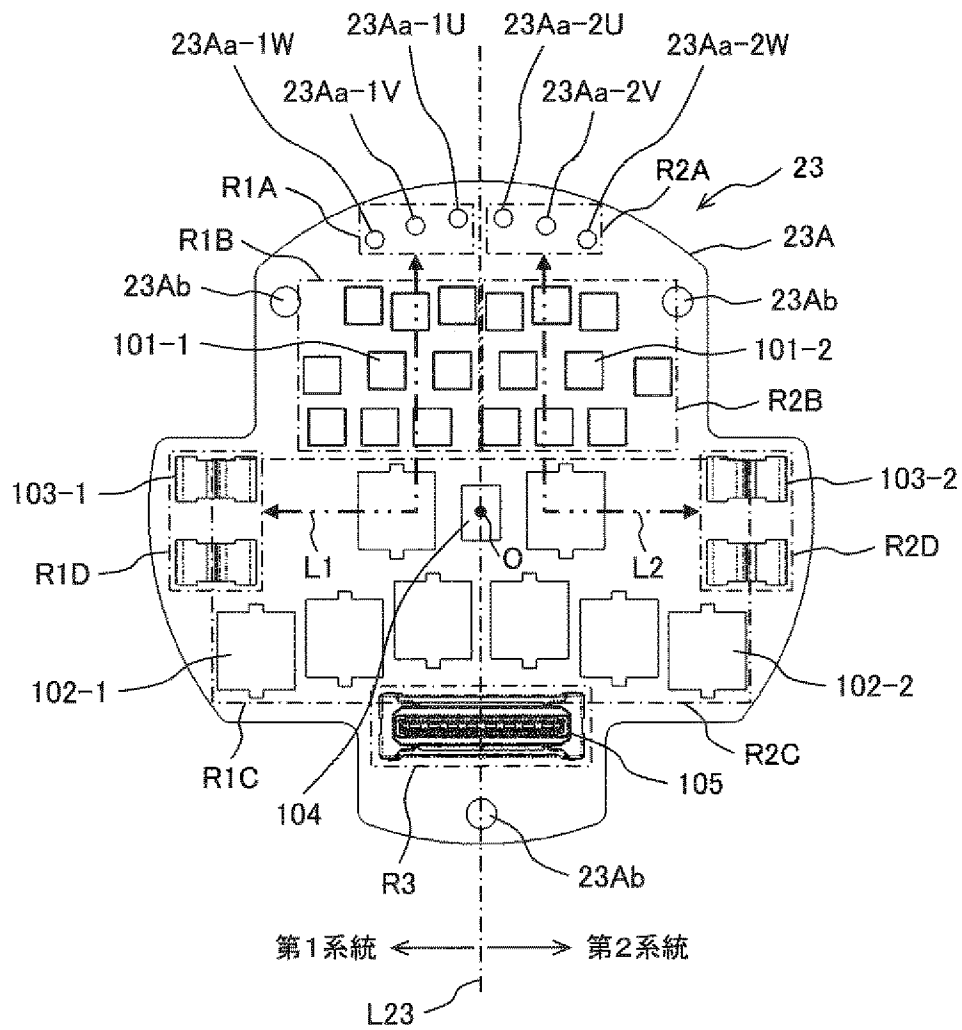
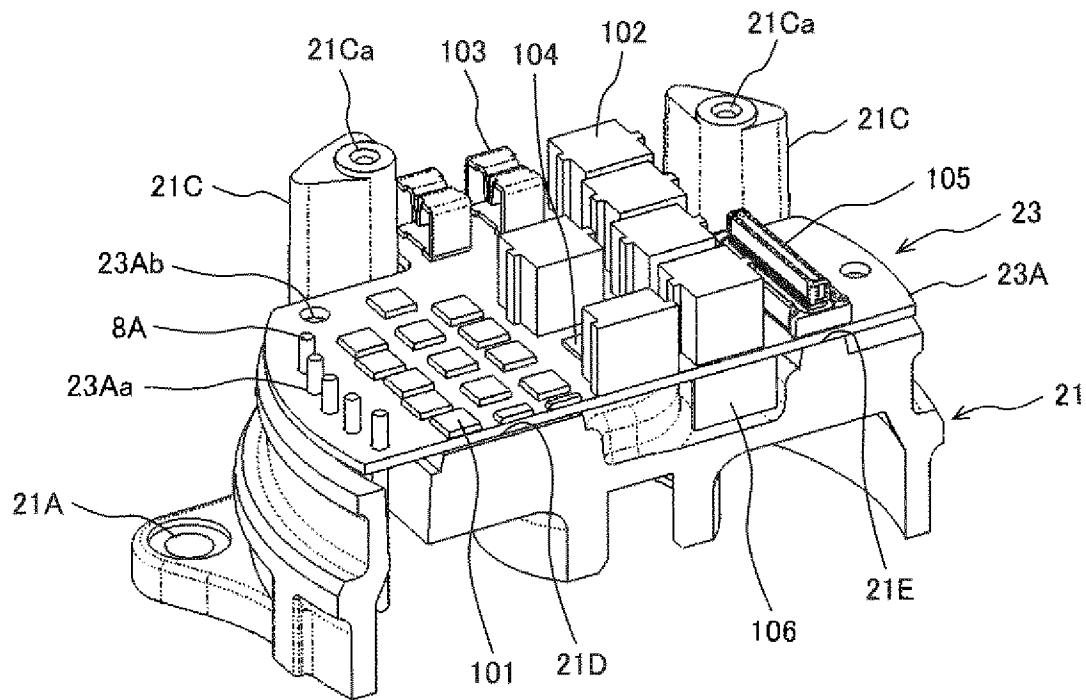


图 4



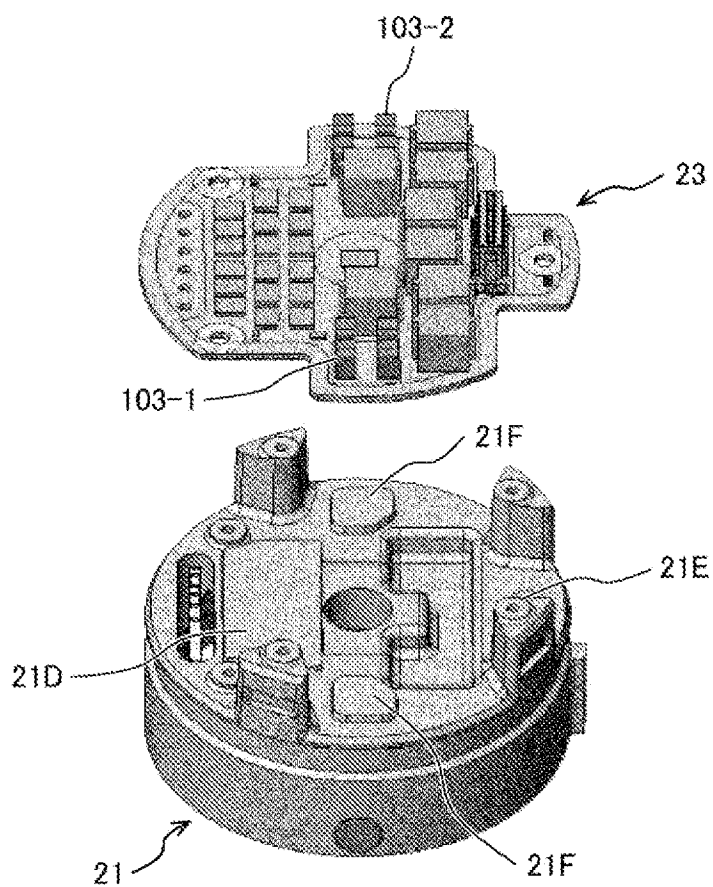
[図5]

図 5



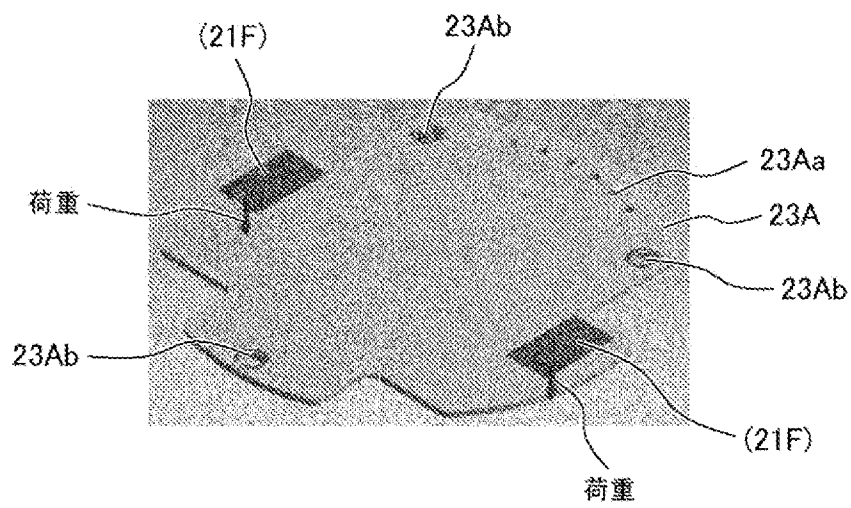
[図6A]

図 6A



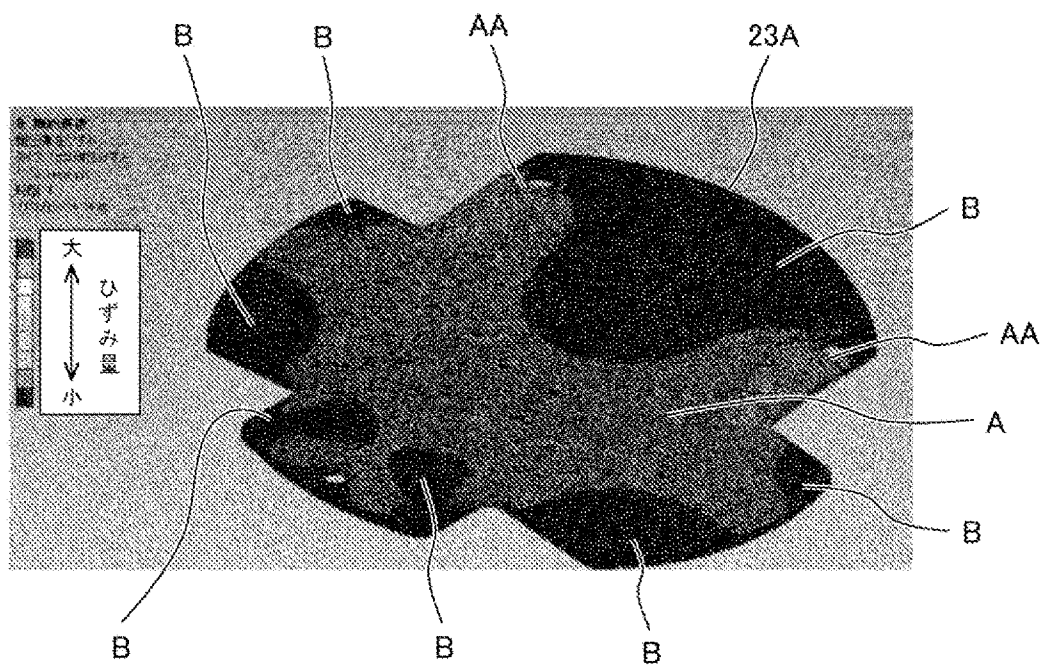
[図6B]

図 6B



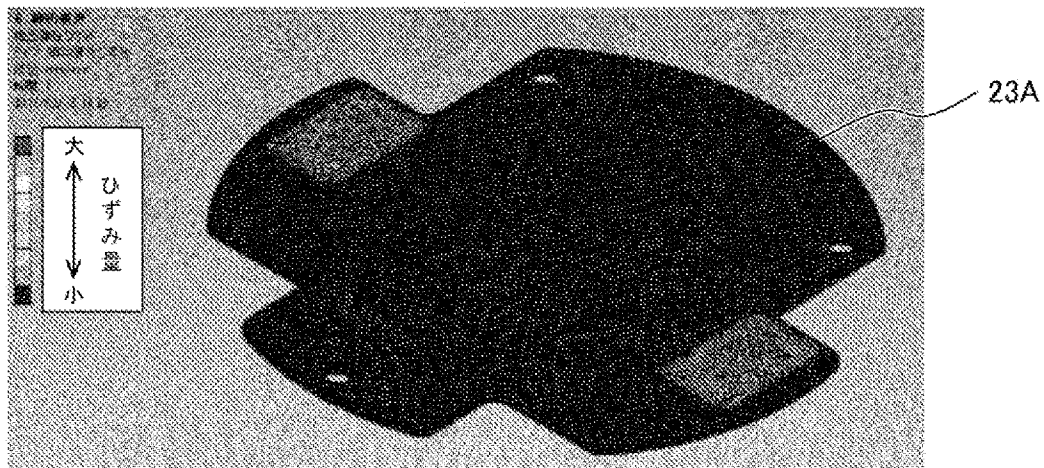
[図6C]

図 6C



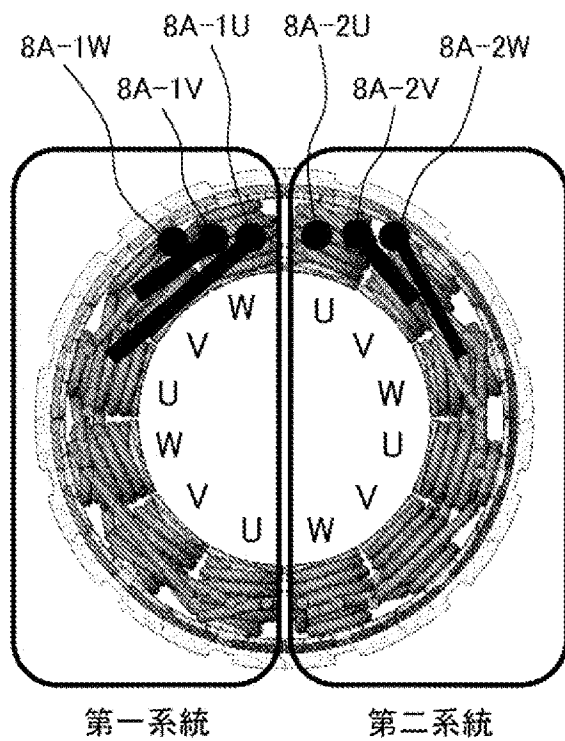
[図6D]

図 6D



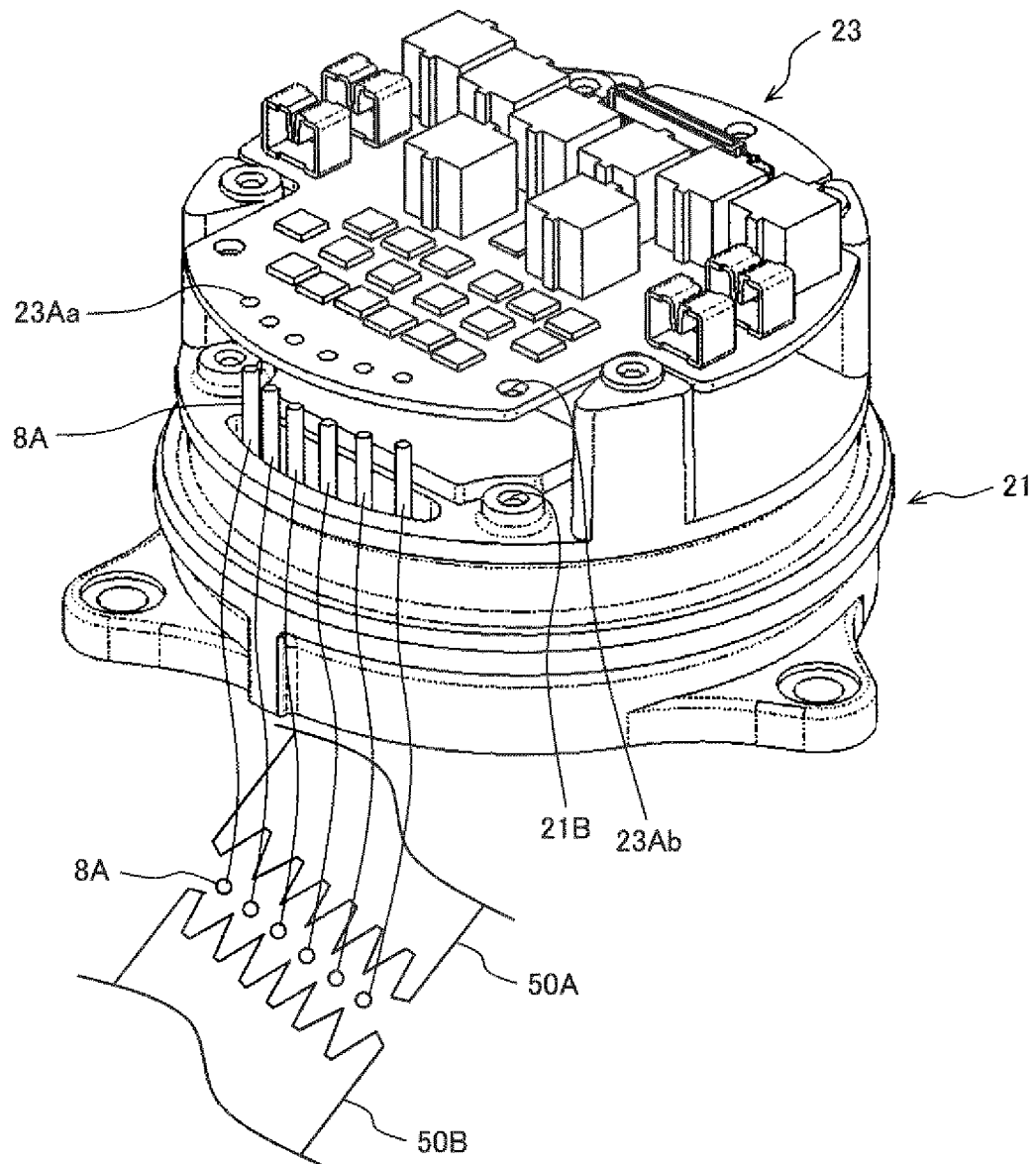
[図7]

図 7



[図8]

図 8



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2019/050495

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H02M 7/48(2007.01)i; H02K 11/33(2016.01)i; H02P 25/22(2006.01)i; B62D 5/04(2006.01)i; H05K 7/14(2006.01)i

FI: H02P25/22; H05K7/14 C; B62D5/04; H02M7/48 Z; H02K11/33

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H02M7/48; H02K11/33; H02P25/22; B62D5/04; H05K7/14

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2020
Registered utility model specifications of Japan	1996-2020
Published registered utility model applications of Japan	1994-2020

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2016-36244 A (DENSO CORP.) 17.03.2016 (2016-03-17) paragraphs [0010]-[0083], fig. 1-20	1-10
Y	JP 2015-193371 A (NIDEC ELESYS CORPORATION) 05.11.2015 (2015-11-05) paragraphs [0019]-[0020], fig. 7	1-10
A	WO 2016/002687 A1 (NSK LTD.) 07.01.2016 (2016-01-07) entire text, all drawings	1-10
A	WO 2017/068636 A1 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP.) 27.04.2017 (2017-04-27) entire text, all drawings	1-10

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

30 March 2020 (30.03.2020)

Date of mailing of the international search report

07 April 2020 (07.04.2020)

Name and mailing address of the ISA/

Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/JP2019/050495

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
JP 2016-36244 A	17 Mar. 2016	US 2016/0036289 A1 paragraphs [0033]- [0154] DE 102015214465 A1 CN 105322722 A	
JP 2015-193371 A	05 Nov. 2015	US 2015/0274197 A1 paragraphs [0028]- [0029] CN 104943743 A	
WO 2016/002687 A1	07 Jan. 2016	US 2017/0133905 A1 entire text, all drawings EP 3163720 A1 CN 106716791 A	
WO 2017/068636 A1	27 Apr. 2017	US 2018/0093698 A1 entire text, all drawings EP 3366547 A1 CN 108137084 A	

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） H02M 7/48(2007.01)i; H02K 11/33(2016.01)i; H02P 25/22(2006.01)i; B62D 5/04(2006.01)i; H05K 7/14(2006.01)i FI: H02P25/22; H05K7/14 C; B62D5/04; H02M7/48 Z; H02K11/33		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） H02M7/48; H02K11/33; H02P25/22; B62D5/04; H05K7/14 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2020年 日本国実用新案登録公報 1996-2020年 日本国登録実用新案公報 1994-2020年 国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2016-36244 A (株式会社デンソー) 17.03.2016 (2016-03-17) 段落[0010]-[0083], 図1-20	1-10
Y	JP 2015-193371 A (日本電産エレシス株式会社) 05.11.2015 (2015-11-05) 段落[0019]-[0020], 図7	1-10
A	WO 2016/002687 A1 (日本精工株式会社) 07.01.2016 (2016-01-07) 全文, 全図	1-10
A	WO 2017/068636 A1 (三菱電機株式会社) 27.04.2017 (2017-04-27) 全文, 全図	1-10
☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☒ パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献 “T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 30.03.2020		国際調査報告の発送日 07.04.2020
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		権限のある職員（特許庁審査官） 池田 貴俊 3V 9256 電話番号 03-3581-1101 内線 3357

国際調査報告
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2019/050495

引用文献			公表日	パテントファミリー文献			公表日
JP	2016-36244	A	17.03.2016	US	2016/0036289	A1	
				段落[0033]-[0154]			
				DE	102015214465	A1	
				CN	105322722	A	
JP	2015-193371	A	05.11.2015	US	2015/0274197	A1	
				段落[0028]-[0029]			
				CN	104943743	A	
WO	2016/002687	A1	07.01.2016	US	2017/0133905	A1	
				全文, 全図			
				EP	3163720	A1	
				CN	106716791	A	
WO	2017/068636	A1	27.04.2017	US	2018/0093698	A1	
				全文, 全図			
				EP	3366547	A1	
				CN	108137084	A	